

【東京/武蔵村山】電気設計 / フリップチップボンダ（半導体製造装置）　◆ヤマハ発動機グループ

ヤマハロボティクス株式会社での募集です。 機械設計・機構設計・筐体設計・メカト...

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
ヤマハロボティクス株式会社

求人ID
1594390

業種
電気・電子・半導体

雇用形態
正社員

勤務地
その他東京

給与
500万円 ~ 850万円

勤務時間
08:45 ~ 17:30

休日・休暇
【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 採用月に応じて2日 ~ 15日 4か月目から 【休日】完全週休二日制...

更新日
2026年10月31日 02:00

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
無し

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
専門学校卒

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2379220】
■業務内容：
最先端半導体の製造装置・フリップチップボンダの電気設計（仕様検討、設計、出図業務、顧客提出資料作成）をお任せ致します。
半導体製造装置の新機種の設計開発（仕様検討、設計、組立、関係書類作成）。各種問合せ対応、生産中止部品対応（問い合わせは顧客から直接受けることはなく、カスタマーサービス部が窓口となります。このポジションでは主に、原因究明、対策、必要書類の作成（検証結果まとめ、顧客説明資料など）、図面修正などを行います。）
※設計する上で使用する部品によっては海外製部品がありますので英語版データシートを理解する必要があります。その

他、拠点間のメールのやり取りでは英語でのやり取りが稀にあります。

■担当製品：フリップチップボンダ
https://www.yamaha robotics.com/products/manufacturer?
maker=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%96%B0%E5%B7%9D

■配属部署と就業環境：
アドバンスドパッケージング部は若手社員が多く活躍しており、想定残業時間は20時間程度・年間休日122日となります。評価制度は、ポテンシャル評価・成果評価に分かれています。評価項目に対し、自己評価を行った上で上長からFBを受け、その後2・3名の承認を行うため、明確で平等な評価制度となります。

■本ポジションの魅力：
フリップチップ実装装置の開発に取り組んでいます。現在、携帯電話に代表されるように電子機器の小型化・軽量化・高機能化が進行しています。しかし高性能化に伴い、ICの実装面積が拡大しています。そのジレンマを解決するためにフリップチップ実装が有効な手段として注目されています。フリップチップ実装されたICはLEDやスマートフォンなどの小型化軽量化が要求される最終製品に使用されます。開発サイクルは約2年ほどとなっており、スキルを身に着けながら、新しいものに携わり続けられるポジションです。

※残業想定時間：20時間程度を想定

■半導体ボンディング装置のパイオニア企業
ー ー

1970年代後半、それまで人の手で行われていたワイヤボンディング（半導体製造における後工程作業）の全自動化に成功したのは当社です。競合が増えた今、当社の強みは品質No.1であり仕様に沿ってカスタマイズ設計ができること。この丁寧さは今後も捨てずに、日本企業としての自信・自負をもって世界No.1であり続けるのが私たちの目標です。

□主力製品「フリップチップボンダ」について
ー ー

半導体製造のための精密ロボットです。
ウェハー上に形成された半導体素子を、反転（フリップ）させて基板上
もしくはウェハー上へボンディングする為の装置で、従来のワイヤボンディングに
替わる新しい実装技術になります。
最新のスマートフォンやデータセンタの中心的な役割を果たすICを
製造する為の装置です。
メカトロニクス技術はもちろん、制振制御、ロボティクス、材料工学、
画像処理技術などあらゆる最先端の技術がつまっています。

スキル・資格

~ 業界未経験歓迎 / 業種未経験歓迎 ~
■必須条件：下記いずれも必須
・なんらか電気設計のご経験
・他領域との協働があるためメカソフトなど別領域にアレルギーのない方

■歓迎条件：
・半導体業界の知見
・英語スキル

会社説明

ヤマハロボティクス株式会社（Yamaha Robotics Co. Ltd.）は、ヤマハ発動機株式会社グループにおいて半導体製造装置（後工程）および電子部品組み立て装置事業を担う会社です。